

「日本実装技術ロードマップ」 報告会の実施概要報告

■主 催：電子実装技術委員会／Jisso戦略専門委員会「実装技術ロードマップG」

■担当部署：知的基盤部

■場 所：秋葉原コンベンションホール

概 要

当協会の「電子実装技術委員会」の下部組織である「Jisso戦略専門委員会」では、「実装技術ロードマップG」を設け、我が国における実装技術の動向及び今後の展望について調査・検討を行っております。

今般「2009年度版日本実装技術ロードマップ」を報告書としてとり纏め、発行致しました。本ロードマップは、①電子機器セット②半導体デバイス／パッケージ③電子部品④プリント配線板⑤実装設備⑥トピックス（燃料電池）のワーキンググループに分けて活動を行い、実装技術（Jisso）の10年後のあるべき姿を想定

することで我が国エレクトロニクス業界全体の競争優位性の維持・向上を促進することを目的として策定しております。この報告書の発行に当たり、その内容等について広く一般にご紹介をさせて頂くために、標記報告会を開催致しました。

経済環境が激しい中、一般申込者（160名）、招待者（2名）、報道関係者（11名）、委員会関係者（20名）、併せて193名（事前申込：168名）の方に参加頂き、大盛況の内に無事終了することが出来ました。

プログラム

○挨拶

委員長 高橋邦明（エスベック(株)）

○機器セットワーキンググループ

主査 間仁田祥（カシオ計算機(株)）

○トピックス（マイクロ燃料電池）

本多進（実装技術NPO法人 サーキットネットワーク）

○半導体パッケージワーキンググループ

主査 春田亮（(株)ルネサステクノロジ）

○電子部品ワーキンググループ

主査 松井淳（TDK(株)）

○プリント配線板ワーキンググループ

副主査 富田清志（京セラSLCテクノロジー(株)）

○実装設備ワーキンググループ

主査 村上秀策（パナソニックファクトリーソリューションズ(株)）

○質疑応答と総括

副委員長 春日壽夫（NECエレクトロニクス(株)）



高橋委員長(実装技術ロードマップG)が挨拶



報告会会場風景